

行业及产业

电子

# 关注半导体新材料的应用进展

——电子行业周报 (2025/10/20-10/24)

## 强于大市

一年内行业指数与沪深300指数对比走势:



资料来源: 聚源数据, 爱建证券研究所

相关研究

《人工智能月度跟踪: OpenAI 推出新一代音视频工具 Sora 2》2025-10-21

《电子行业周报: 国产示波器实现高端突破》2025-10-20

《电子行业周报: 湾芯展: 期待新凯来新惊喜》2025-10-13

《电子行业周报: 先进封装玻璃基板实现技术突破》2025-10-09

《电子行业周报: AI 服务器+智能手机需求爆发推动 NAND Flash 价格上扬》2025-09-29

证券分析师

许亮  
S0820525010002  
0755-83562506  
xuliang@ajzq.com

联系人

朱俊宇  
S0820125040021  
021-32229888-25520  
zhujunyu@ajzq.com

投资要点:

- **印制电路板领涨电子行业。**本周 (2025/10/20-10/24) SW 电子行业指数 (+8.49%)，涨跌幅排名 2/31 位，沪深 300 指数 (+3.24%)。SW 一级行业指数涨跌幅前五别为：通信 (+11.55%)，电子 (+8.49%)，电力设备 (+4.90%)，机械设备 (+4.71%)，石油石化 (+4.33%)，涨跌幅后五分别为：农林牧渔 (-1.36%)，食品饮料 (-0.95%)，美容护理 (-0.09%)，纺织服饰 (+0.37%)，钢铁 (+0.44%)。本周 SW 电子三级行业指数涨跌幅前三分别是：印制电路板 (+14.05%)，数字芯片设计 (+10.51%)，消费电子零部件及组装 (+9.86%)；涨跌幅后三分别是：面板 (+2.30%)，半导体材料 (+3.11%)，模拟芯片设计 (+4.10%)。
- **事件：**2025 年 10 月 9 日，中国商务部与海关总署联合发布公告，对工业级人造金刚石微粉（粒径≤50μm）、单晶（50-500μm）、线锯、砂轮等物项实施出口许可管理，自 2025 年 11 月 8 日起生效。此次管制范围较 2024 年 8 月 15 日进一步扩大，从设备技术延伸至终端材料。
- **金刚石是新一代宽禁带半导体的核心代表，兼具超宽带隙、高电子迁移率、高热导率等优势。**其核心性能参数显著优于传统半导体材料：禁带宽度达 5.50eV（约为硅的 4.91 倍），电子迁移率达 2200cm<sup>2</sup>·V<sup>-1</sup>·s<sup>-1</sup>（约为硅的 1.63 倍），热导率更是高达 20W·cm<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>（约为硅的 14.29 倍）。凭借这些优势，金刚石在新能源、5G 通信、航空航天等多领域具备不可替代的应用前景。随着芯片技术发展的推进，硅基材料在集成度、功耗等方面逼近物理极限，且其 1.12eV 的禁带宽度无法满足高功率、高频场景需求，推动砷化镓、碳化硅、金刚石等新型宽禁带半导体材料研发。
- **金刚石作为碳的同素异形体，是自然界最坚硬的物质，分为人造与天然两类，其中工业领域以人造金刚石为主。**1) **从产品类型看，工业金刚石主要分为金刚石单晶和金刚石微粉，**前者包括磨削级单晶、大单晶等，后者包含研磨用、线锯用等多种类型，二者广泛应用于磨削、切割、超精密加工等工业场景。2) **从合成技术看，金刚石合成以 HTHP 高温高压法和 CVD 化学气相沉积法为主。**HTHP 技术成熟，国内应用广泛，产品以颗粒状的金刚石单晶、培育钻石为主，多用于加工工具和饰品；而 CVD 法国外技术更成熟，国内尚处研究阶段，产品以片状的金刚石膜、培育钻石为主，产品侧重光、电等功能性应用。
- **随着芯片性能持续提升，TDP（热设计功耗）的增长逐渐成为制约 GPU 性能释放的核心瓶颈。**以 NVIDIA 为例，其 AI 芯片功耗已从 A100 的 400W 逐步攀升至 GB200 的 1200W、GB300 的 1400W，算力提升与功耗增长的同步性凸显了散热需求的迫切性。金刚石凭借远超传统散热材料的优异导热性，可有效降低 GPU 工作温度、助力突破热瓶颈，其中 AKASH SYSTEMS 自主研发的 GPU-on-diamond 技术已实现 GPU 温度最高降低 60%、性能提升 2-4 倍的效果，印证了其在高端芯片散热领域的应用价值。
- **投资建议：**随着人造金刚石被纳入出口管制，我们认为金刚石等宽禁带半导体材料的优异性能正在被工业界所重视。除了金刚石以外，SiC 和 GaN 等新兴半导体已经实现了量产及应用。国内主要供应商主要包括天岳先进（688234.SH）和英诺赛科（2577.HK）正在积极拓展下游应用并持续扩产，建议关注半导体新材料板块的投资机会。
- **风险提示：**1) 国际贸易摩擦加剧 2) 下游需求不及预期 3) 技术升级进度滞后

# 目录

<b>1. 关注半导体新材料的应用进展</b>	<b>4</b>
1.1 金刚石综合性能远超传统半导体材料	4
1.2 金刚石概述	4
1.3 GPU 功耗持续攀升，金刚石散热性能显著	7
<b>2. 全球产业动态</b>	<b>9</b>
2.1 DeepSeek 发布 DeepSeek-OCR 模型	9
2.2 英特尔发布 2025Q3 财报	9
2.3 英伟达竞争对手 Axelira 推出 Europa 芯片	10
2.4 天域半导体通过港交所上市聆讯	10
2.5 马斯克宣布三星与台积电共同设计生产特斯拉 AI5 芯片	11
<b>3. 本周市场回顾</b>	<b>12</b>
3.1 SW 一级行业涨跌幅一览	12
3.2 SW 电子三级行业市场表现	13
3.3 SW 电子行业个股情况	13
3.4 SW 科技行业其他市场表现	14
<b>4. 风险提示</b>	<b>15</b>

## 图表目录

图表 1：金刚石带宽、电子与空穴迁移率较高.....	4
图表 2：金刚石性能参数显著优于传统半导体材料.....	4
图表 3：人造金刚石与天然金刚石核心差异.....	5
图表 4：金刚石广泛被应用于工业精细研磨、切割等领域.....	5
图表 5：工业金刚石产品类型可划分为金刚石单晶和金刚石微粉.....	6
图表 6：CVD 和 HTHP 是当前金刚石合成领域最主要的两种方法.....	6
图表 7：NVIDIA 芯片算力持续提升.....	7
图表 8：NVIDIA 各芯片 TDP 功耗梳理.....	7
图表 9：金刚石 GPU 与非金刚石 GPU 参数对比.....	8
图表 10：AKASH System 钻石散热降低 GPU 60%温度.....	8
图表 11：本周 SW 一级行业涨跌幅一览.....	12
图表 12：本周 SW 电子三级行业涨跌幅一览.....	13
图表 13：SW 电子个股本周涨跌幅前十.....	14
图表 14：SW 电子个股本周涨跌幅后十.....	14
图表 15：本周费城半导体指数.....	14
图表 16：本周恒生科技指数.....	14
图表 17：本周中国台湾电子指数涨跌幅一览.....	15

## 1. 关注半导体新材料的应用进展

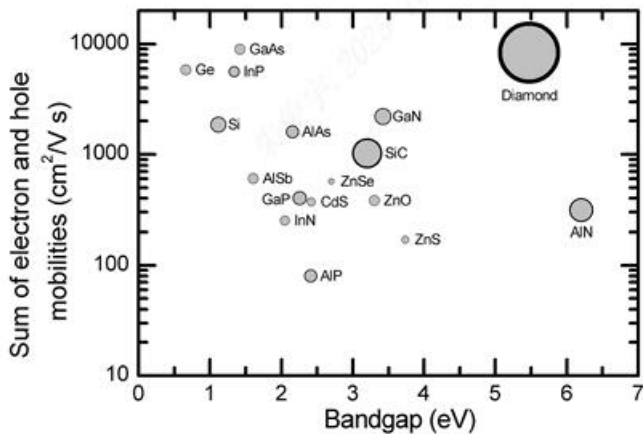
**事件：**2025年10月9日，中国商务部与海关总署联合发布公告，对工业级人造金刚石微粉（粒径 $\leq 50\mu\text{m}$ ）、单晶（50-500 $\mu\text{m}$ ）、线锯、砂轮等物项实施出口许可管理，自2025年11月8日起生效。此次管制范围较2024年8月15日进一步扩大，从原有的合成设备与技术延伸至终端材料。

### 1.1 金刚石综合性能远超传统半导体材料

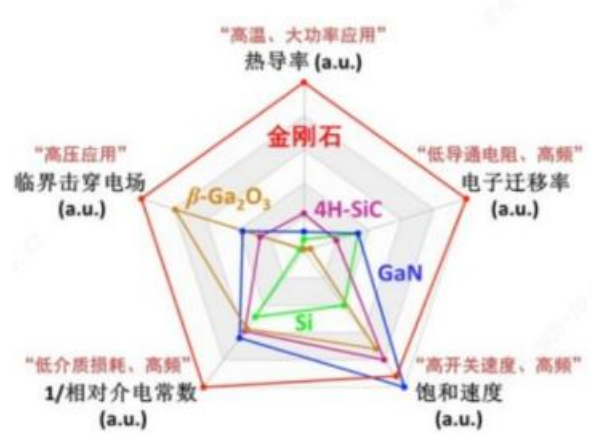
金刚石是新一代宽禁带半导体的核心代表，兼具超宽带隙、高电子迁移率、高热导率等综合优势。其核心性能参数显著优于传统半导体材料：禁带宽度达5.50eV（约为硅的4.91倍），电子迁移率 $2200\text{cm}^2\text{V}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ （约为硅的1.63倍），热导率更是高达 $20\text{W}\text{cm}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ （约为硅的14.29倍）。

随着芯片技术的发展，硅基材料在散热、高频等技术指标逐渐逼近物理极限。硅（Si）的禁带宽度仅为1.12eV，难以满足高功率、高频场景的应用需求，这推动了对宽禁带、高热导性、高击穿场强新型半导体材料的研发，砷化镓（GaAs）、碳化硅（SiC）、金刚石等材料应运而生。

图表 1：金刚石带宽、电子与空穴迁移率较高



图表 2：金刚石性能参数显著优于传统半导体材料



资料来源：Chemical vapour deposition synthetic diamond: materials, technology and applications, 爱建证券研究所

资料来源：中国粉体网, 爱建证券研究所

凭借这些特性，金刚石在新能源与智能电网（高压器件）、轨道交通与新能源汽车（电驱散热）、5G通信与物联网（射频器件）、光电子与显示（紫外探测）、消费电子与工业电机（高效散热）、航空航天与军工（抗辐照器件）等领域具备不可替代的应用前景。

### 1.2 金刚石概述

金刚石是碳元素的一种同素异形体，又称“钻石”，是自然界中最坚硬的物质。目前市场上的金刚石主要分为人造金刚石与天然金刚石两类，其中工业领域以人造金刚石为主，仅少量特殊场景适配天然金刚石。工业级人造金刚石主要依托高硬度特性，用于工业精细研磨、高硬材料切割等领域。

图表 3：人造金刚石与天然金刚石核心差异

类别	人造金刚石	天然金刚石
形成过程	通过人为控制的高温高压环境，使用石墨等碳质原料在实验室中合成，形成过程相对较快且可控。	在自然环境中通过高温高压形成的，通常存在于地壳的深处，形成过程复杂且耗时较长。
物理性质	晶形多为立方体、八面体或其过渡形态，表面较为光滑。	晶形通常较为复杂，晶面呈曲晶面，晶棱和晶面钝化，形态常呈浑圆状。
应用领域	因其高硬度和耐磨性，广泛应用于工业切割工具、磨料等领域。	因其稀有性和高价值，常被用作贵重宝石和高端工艺品。

资料来源：智研咨询，爱建证券研究所

图表 4：金刚石广泛被应用于工业精细研磨、切割等领域



资料来源：海光智能科技，爱建证券研究所

**工业金刚石产品类型可划分为金刚石单晶和金刚石微粉两大类。**其中，金刚石单晶包含磨削级单晶（又分粒度 60/70 目以细与以粗的不同规格，分别具备晶体完整热稳定性高或晶形规则机械强度高的特性）、大单晶（粒度 20/25 目以粗且晶体杂质少，用于有色金属、芯片晶圆等的超精密加工工具）；金刚石微粉涵盖研磨用微粉（粒径 7 $\mu$ m 以下、高纯度，适配精密元器件等的研磨抛光）、线锯用微粉（粒径 7-14 $\mu$ m、多棱角，用于蓝宝石、单晶硅等硬脆材料切割）、复合片用微粉粉体（粒径 14 $\mu$ m 以上、耐高温耐磨，用于 PDC 复合片等开采勘探工具）及其他工具用微粉（粒径 14 $\mu$ m 以上、分散性好，用于陶瓷石材等的磨削工具）。

**图表 5：工业金刚石产品类型可划分为金刚石单晶和金刚石微粉**

产品类别	产品名称	产品特性	应用场景
金刚石单晶	磨削级单晶	粒度范围集中在 60/70 目以细；晶体完整、热稳定性高、低磁性	主要用于制作砂轮、磨轮、磨块、滚轮、滚筒等磨削工具，多用于硬质合金、石材、陶瓷和玻璃等非金属硬脆材料的磨削以及抛光等
	磨削级单晶	粒度范围集中在 60/70 目以粗，20/25 以细；晶形规则、边缘锋利、机械强度高	主要用于制作锯片、绳锯和刀具等锯切工具，多用于大理石、花岗岩、混凝土建筑材料以及半导体硅片、光学玻璃、陶瓷等非金属硬脆材料的锯断和切割等
	大单晶	粒度范围集中在 20/25 目以粗，晶体完整，内部杂质较少	主要用于制作金刚石钻头、刀具、修整器等工具，多用于有色金属、光学平面镜、芯片晶圆等的超精密加工及磨床砂轮修整等
金刚石微粉	研磨用微粉	体相端粒径主要为 7μm 以下，粒度分布极为集中，晶型规则，微粉颗粒强度高，杂质含量极低	主要用于制作研磨膏和研磨液等，多用于精密元器件、精细陶瓷、液晶玻璃、宝石及半导体等产品的研磨和抛光
	线锯用微粉	粉体粗端粒径主要为 7-14μm，晶型较好，多棱角、锋利度好、粒度分布集中	主要用于制作金刚石线锯等，多用于蓝宝石、单晶硅、多晶硅、精密陶瓷、磁性材料等硬脆材料的切割
	复合片用微粉粉体	粗端粒径主要为 14μm 以上，耐高温、晶型规整度高、强度高、表面杂质含量 ppm 级、热稳定性好、耐磨性能好	主要用于 PDC 复合片、PCD 刀具用复合片、拉丝模等。终端主要应用于开采及勘探等
	其他工具用微粉	粉体粗端粒径主要为 14μm 以上，晶形规则、粒度分布集中、颗粒形状呈浑圆状、具有良好的分散性、耐磨性	主要用于制作砂轮、磨片、复合片等其他工具，多用于陶瓷、石材和玻璃等材料的磨削

资料来源：钻石股份招股说明书，爱建证券研究所

**CVD（化学气相沉积法）与 HTHP（高温高压法）是当前金刚石合成领域最主要的两种方法，二者在技术路径与应用场景上差异显著，共同支撑人工金刚石的多元需求。**

**1) HTHP 高温高压法：**以石墨粉、金属触媒粉为原料，通过六面顶压机在高温高压环境下合成，产品以颗粒状的金刚石单晶、培育钻石为主。其中，金刚石单晶多用于加工工具核心耗材，培育钻石用于钻石饰品；该技术成熟度高，国内应用广泛，在全球市场具备明显优势。

**2) CVD 化学气相沉积法：**以含碳气体（如 CH<sub>4</sub>）、氢气为原料，通过 CVD 沉积设备在高温低压环境下合成，产品以片状的金刚石膜、培育钻石为主。其核心应用于光、电、声等功能性材料领域，少量用于工具和钻石饰品；目前国外技术相对成熟，国内尚处研究阶段，应用成果较少。

**图表 6：CVD 和 HTHP 是当前金刚石合成领域最主要的两种方法**

产品类别	项目	高温高压法（HTHP）	化学气相沉积法（CVD）
合成技术	主要原料	石墨粉、金属触媒粉	含碳气体（CH <sub>4</sub> ）、氢气
	生产设备	六面顶压机	CVD 沉积设备
	合成环境	高温高压环境	高温低压环境
	主要产品	金刚石单晶、培育钻石	金刚石膜、培育钻石
	产品特点	颗粒状	片状
应用情况	应用领域	金刚石单晶主要作为加工工具核心耗材；培育钻石用于钻石饰品	主要作为光、电、声等功能性材料，少量用于工具和钻石饰品
	主要性能	超硬、耐磨、抗腐蚀等力学性能	光、电、磁、声、热等性能
	应用程度	技术成熟，国内应用广泛且在全球具备明显优势	国外技术相对成熟，国内尚处研究阶段，应用成果较少

资料来源：钻石股份招股说明书，爱建证券研究所

### 1.3 GPU 功耗持续攀升，金刚石散热性能显著

随着芯片性能的提升，TDP（热设计功耗）的增加成为制约 GPU 性能的核心因素。在芯片层面，以 NVIDIA 为代表的主流厂商产品，在算力提升的同时功耗同步快速增长：从实测数据看，NVIDIA AI 芯片功耗已从 A100 的 400W 攀升至 GB200 的 1200W、GB300 的 1400W。

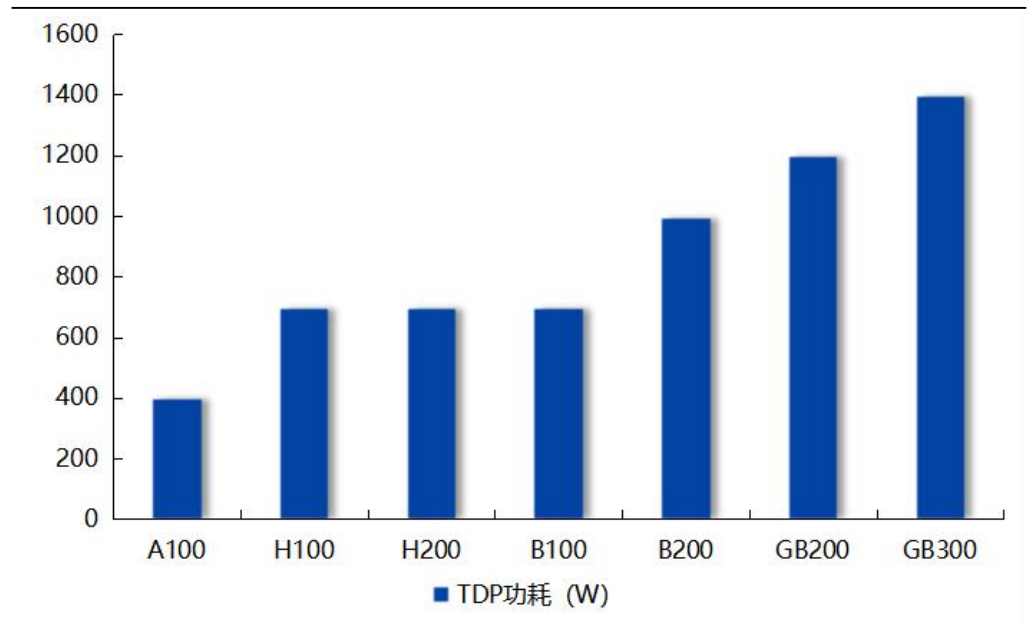
图表 7：NVIDIA 芯片算力持续提升

算力类型	A100	H100	H200	B100	B200	GB200
FP16 (FLOPS)	312T	1P	1P	1.75P	2.25P	5P
FP8 (FLOPS)	-	2P	2P	3.5P	4.5P	10P
INT8 (OPS)	624T	2P	2P	3.5P	4.5P	10P
FP6 (FLOPS)	-	-	-	3.5P	4.5P	10P
FP4 (FLOPS)	-	-	-	7P	9P	20P
NVLink 带宽	600GB/s	900GB/s	900GB/s	1.8TB/s	1.8TB/s	3.6TB/s

资料来源：NVIDIA 官网，eefocus，爱建证券研究所

注：仅列举 NVIDIA 代表产品

图表 8：NVIDIA 各芯片 TDP 功耗梳理



资料来源：VERTIV，爱建证券研究所

凭借远超传统散热材料的优异热导性，金刚石（钻石）可有效降低 GPU 工作温度，助力其突破热瓶颈、充分释放性能，最终提升计算机整体运行表现。AKASH SYSTEMS 自主研发的 GPU-on-diamond 技术，可将 GPU 温度最高降低 60%，同时使芯片性能提升 2-4 倍。

图表 9: 金刚石 GPU 与非金刚石 GPU 参数对比



资料来源: EET ESM EDN 官方社区, 爱建证券研究所

图表 10: AKASH System 钻石散热降低 GPU 60%温度



资料来源: AKASH SYSTEMS, Tom's Hardware, 爱建证券研究所

## 2. 全球产业动态

### 2.1 DeepSeek 发布 DeepSeek-OCR 模型

10月20日,人工智能团队 DeepSeek AI 正式发布全新多模态模型 DeepSeek-OCR。该模型以“探索视觉-文本压缩边界”为核心目标,从大语言模型(LLM)视角重新定义视觉编码器的功能定位,为文档识别、图像转文本等高频场景,提供了兼顾精度与效率的全新解决方案,引发技术领域与行业应用端的广泛关注。

DeepSeek-OCR 采用分层设计的视觉编码方案,支持 Tiny、Small、Base、Large、Gundam 五种尺寸配置,用户可根据不同硬件条件与场景需求灵活选择。其中,Gundam 版本特别针对大尺寸复杂文档优化,采用 1024×640 混合尺寸配置及专属裁剪模式,能更精准处理多栏排版、图文混杂的专业文档。

值得关注的是,该模型创新性融合了 SAM (Segment Anything Model) 的图像分割能力与 CLIP 的视觉理解能力,并通过 MlpProjector 模块实现与语言模型的高效对接。这一设计不仅让模型能精准提取文本内容,还能同步捕捉文字、表格、图像在原图中的空间布局信息。

在实际功能层面,DeepSeek-OCR 展现出极强的多场景适应性:既支持单张图像、PDF 文档的单次处理,也能应对批量图像的高效识别,且所有输出结果均支持 Markdown 格式,方便用户直接编辑或导入其他办公软件;同时,模型内置边界框检测功能,可精准定位文本块、表格、插图在原图中的位置,结合动态裁剪策略,能根据图像尺寸自动调整处理逻辑,在保证识别精度的同时大幅提升处理速度。

此外,模型还集成 vllm 框架实现高效推理,支持多任务并发处理。

### 2.2 英特尔发布 2025Q3 财报

10月24日,英特尔公司发布 2025Q3 财报。财报显示,公司 Q3 营收达 137 亿美元,同比增长 3%;毛利率为 38.2%,营业利润率从 2025Q2 的-24.7%回升至 5.0%。

分部门来看,核心产品板块中,客户端计算事业部(CCG) Q3 营收 85 亿美元,同比增长 5%;数据中心与人工智能事业部(DCAI) 营收 41 亿美元,同比下滑 1%;此外,英特尔代工业务营收 42 亿美元,同比下滑 2%。

#### 本季度,英特尔达成多项关键里程碑:

- 1) 美国政府宣布向其合计投资 89 亿美元,目前已有 57 亿美元到账;
- 2) 英特尔与英伟达达成产品合作,并将获得这家 AI 巨头 50 亿美元投资;
- 3) 软银向其注资 20 亿美元;
- 4) 公司发布酷睿 Ultra300“PantherLake”架构,正式展示至强 6+“ClearwaterForest”处理器,同时公布推理优化 GPU“CrescentIsland”项目;采用 Intel18A 制程的亚

利桑那州钱德勒市 Fab52 晶圆厂全面投产运营。

对于 2025Q4，英特尔给出业绩指引：预计营收将达 128-138 亿美元，GAAP 毛利率预计约 34.5%。

## 2.3 英伟达竞争对手 Axelira 推出 Europa 芯片

10 月 21 日，Axelera® AI 于荷兰埃因霍温宣布推出最新 AI 处理器单元 (AIPU) ——Europa。该芯片旨在为多用户生成式 AI 及计算机视觉应用树立性能与性价比新标杆。Europa 在设计上融合了强劲处理性能、优异能效与热管理效率、紧凑封装设计及多元形态选择，使其成为从边缘端到企业服务器等计算密集型多模态 AI 推理应用的理想之选。

Europa AIP 的峰值性能达 214TOPS，功耗仅 45 瓦，能够精准匹配高效能计算需求。该芯片搭载了 64GB 内存及 128MB 片上 L2 SRAM，可提供 25GB/s (200 Gbps) 带宽，有效保障高吞吐量与低延迟。凭借这一高效能设计，其性能效率较同类产品提升 3 至 5 倍，堪称生成式 AI 解决方案的优选。公司管理层表示：“企业不应在所需计算能力与实际可获取性之间妥协，而 Europa 的出现，让企业级 AI 处理能力几乎触手可及。”

Axelera 还将推出 Europa AIPU 的 PCIe 卡形态产品，支持多元形态配置，可满足不同工作负载需求。预计 Europa AIPU 及配套 PCIe 卡将于 2026 年上半年启动发货。

## 2.4 天域半导体通过港交所上市聆讯

广东天域半导体股份有限公司于 2025 年 10 月 21 日成功通过香港交易所上市聆讯，这标志着中国领先的碳化硅 (SiC) 外延片供应商即将正式登陆国际资本市场。该公司成立于 2009 年，总部位于广东东莞，本次 IPO 由中信证券担任独家保荐人，同时获得华为、比亚迪等产业巨头的战略投资。

天域半导体专注于碳化硅外延片的研发、量产与销售，产品覆盖 4 英寸、6 英寸及 8 英寸等多种规格，广泛应用于新能源汽车、光伏、充电桩、储能、轨道交通、智能电网、通用航空 (如 eVTOL) 及家电等领域，可充分满足下游产业对高性能半导体材料的迫切需求。

天域半导体招股书数据显示，公司 2024 年实现营收 5.20 亿元，同期录得毛利润亏损 3.74 亿元、净利润亏损 5.00 亿元；2025 年前 5 个月经营状况显著改善，营收达 2.57 亿元，净利润则实现 0.10 亿元盈利。

本次 IPO 所募集的资金，将主要用于未来五年内的产能扩张、研发创新能力提升、战略投资与收购、全球销售及营销网络拓展，以及补充营运资金等方面。

## 2.5 马斯克宣布三星与台积电共同设计生产特斯拉 AI5 芯片

10 月 23 日，特斯拉马斯克在特斯拉 2025Q3 电话会议上宣布，三星电子将与台积电共同设计和生产特斯拉人工智能 5 号芯片（AI5）。这一消息标志着三星在由台积电主导的半导体市场中逐渐占据更重要的地位。马斯克强调，特斯拉并不打算取代英伟达在人工智能硬件领域的领导地位，而是将 AI5 芯片与英伟达的硬件协同使用，以推动自动驾驶和机器人产品线的发展。

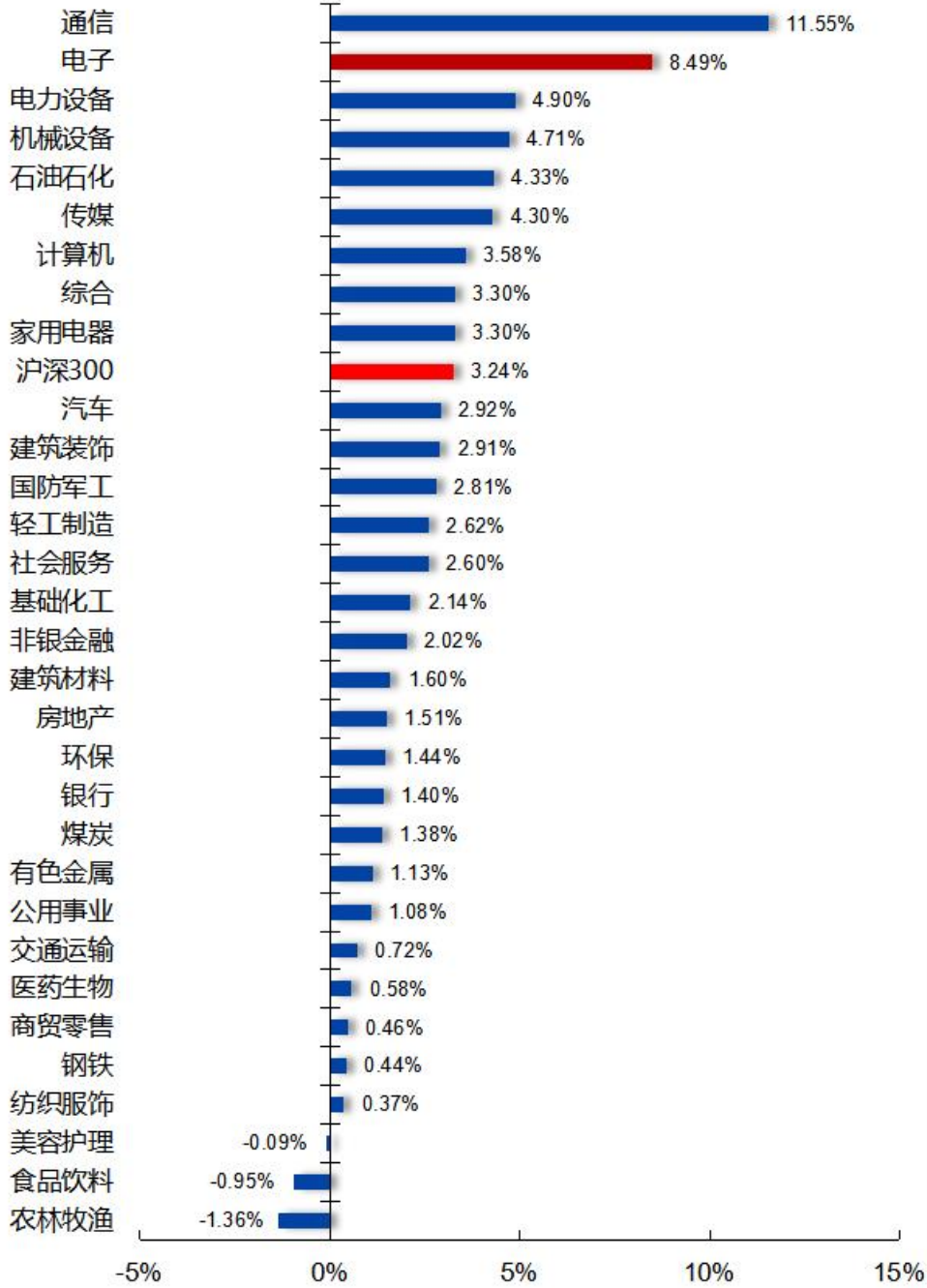
AI5 芯片的性能是其前一代 AI4 芯片的 40 倍，算力提升了 8 倍，内存增加了 9 倍。马斯克表示，特斯拉希望 AI5 芯片能够实现供给过剩，未来多余的芯片可用于数据中心等其他用途，该芯片预计将于 2026 年投入量产。值得注意的是，特斯拉与三星已于 2025 年 7 月签署一项价值 165 亿美元的协议，合同有效期从 2025 年 7 月 24 日至 2033 年 12 月 31 日，计划共同开发未来多代人工智能芯片及计算平台，包括 AI6 芯片。

### 3. 本周市场回顾

#### 3.1 SW 一级行业涨跌幅一览

本周 SW 电子行业指数 (+8.49%)，涨跌幅排名 2/31 位，沪深 300 指数 (+3.24%)。SW 一级行业指数涨跌幅前五别为：通信 (+11.55%)，电子 (+8.49%)，电力设备 (+4.90%)，机械设备 (+4.71%)，石油石化 (+4.33%)，涨跌幅后五分别为：农林牧渔 (-1.36%)，食品饮料 (-0.95%)，美容护理 (-0.09%)，纺织服饰 (+0.37%)，钢铁 (+0.44%)。

图表 11：本周 SW 一级行业涨跌幅一览



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

### 3.2 SW 电子三级行业市场表现

本周 SW 电子三级行业指数涨跌幅前三分别是：印制电路板（+14.05%），数字芯片设计（+10.51%），消费电子零部件及组装（+9.86%）；涨跌幅后三分别是：面板（+2.30%），半导体材料（+3.11%），模拟芯片设计（+4.10%）。

图表 12：本周 SW 电子三级行业涨跌幅一览



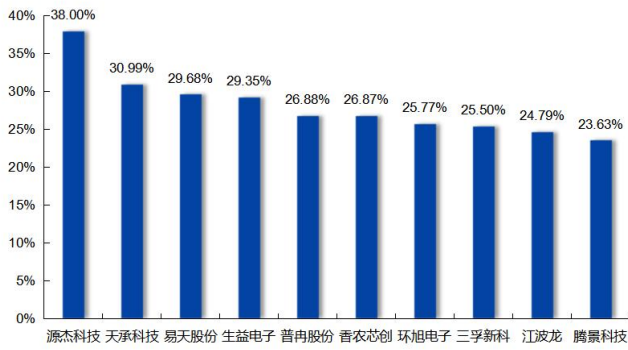
资料来源：iFinD，爱建证券研究所

### 3.3 SW 电子行业个股情况

本周 SW 电子行业涨跌幅排名前十的股票分别是：源杰科技（+38.00%），天承科技（+30.99%），易天股份（+29.68%），生益电子（+29.35%），普冉股份（+26.88%），香农芯创（+26.87%），环旭电子（+25.77%），三孚新科（+25.50%），江波龙（+24.79%），腾景科技（+23.63%）。

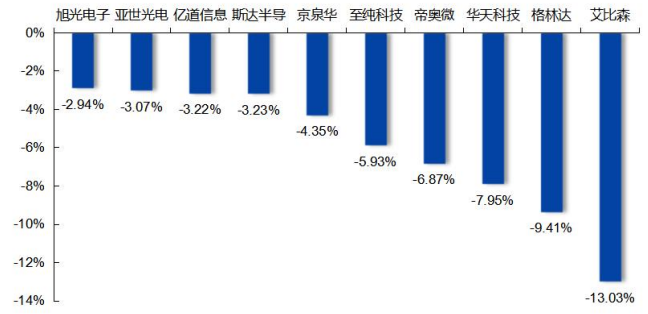
涨跌幅排名后十的股票分别是：艾比森（-13.03%），格林达（-9.41%），华天科技（-7.95%），帝奥微（-6.87%），至纯科技（-5.93%），京泉华（-4.35%），斯达半导（-3.23%），亿道信息（-3.22%），亚世光电（-3.07%），旭光电子（-2.94%）。

图表 13: SW 电子个股本周涨跌幅前十



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

图表 14: SW 电子个股本周涨跌幅后十

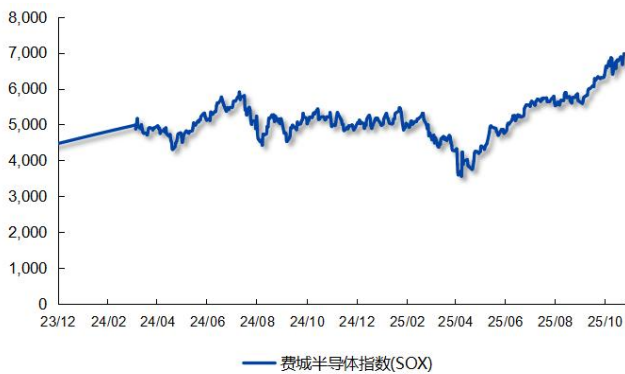


资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

### 3.4 SW 科技行业其他市场表现

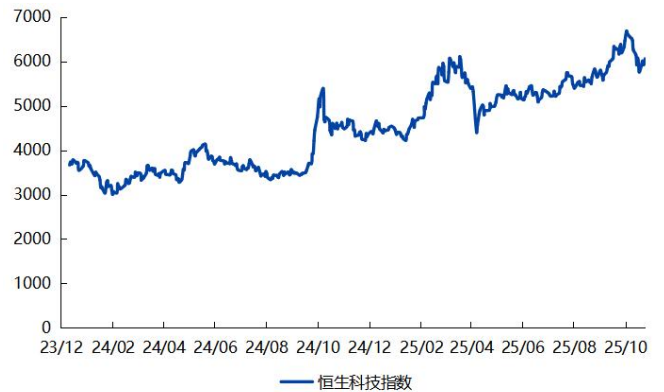
费城半导体指数 (SOX) 本周涨跌幅为+2.94%; 恒生科技指数本周涨跌幅为+5.20%。

图表 15: 本周费城半导体指数



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

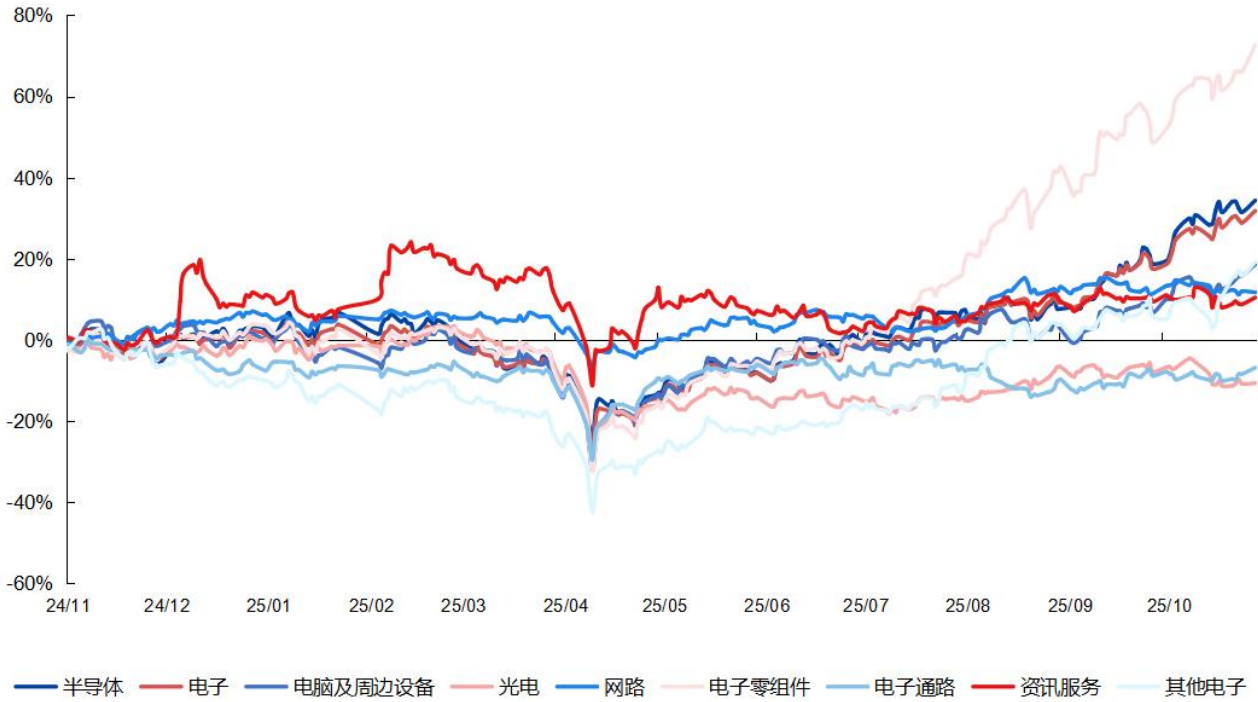
图表 16: 本周恒生科技指数



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

截至 2025/10/23 中国台湾电子指数各板块涨跌幅分别是: 半导体 (-1.89%), 电子 (-0.72%), 电脑及周边设备 (+1.92%), 光电 (-0.55%), 网路 (-0.14%), 电子零组件 (+0.58%), 电子通路 (+0.28%), 资讯服务 (-0.56%), 其他电子 (+5.23%)。

图表 17: 本周中国台湾电子指数涨跌幅一览



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

## 4. 风险提示

- 1) 国际贸易摩擦加剧
- 2) 下游需求不及预期
- 3) 技术升级进度滞

## 爱建证券有限责任公司

上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号

电话: 021-32229888

传真: 021-68728700

服务热线: 956021

邮政编码: 200124

邮箱: ajzq@ajzq.com

网址: <http://www.ajzq.com>

## 评级说明

### 投资建议的评级标准

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场：沪深 300 指数（000300.SH）；新三板市场：三板成指（899001.CSI）（针对协议转让标的）或三板做市指数（899002.CSI）（针对做市转让标的）；北交所市场：北证 50 指数（899050.BJ）；香港市场：恒生指数（HIS.HI）；美国市场：标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）。

### 股票评级

买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~15%之间
持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
卖出	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%

### 行业评级

强于大市	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
弱于大市	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

## 分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告采用信息和数据来自公开、合规渠道，所表述的观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的独立看法。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法可能存在局限性，请谨慎参考。

## 法律主体声明

本报告由爱建证券有限责任公司（以下统称为“爱建证券”）证券研究所制作，爱建证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管。

本报告是机密的，仅供我们的签约客户使用，爱建证券不因收件人收到本报告而视其为爱建证券的签约客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但爱建证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供签约客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，爱建证券及其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测后续可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，爱建证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

## 版权声明

本报告版权归爱建证券所有，未经爱建证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。版权所有，违者必究。